

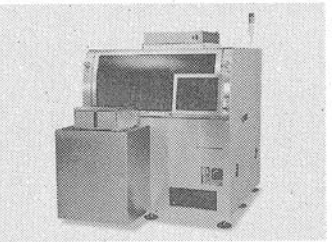
ICチップ実装装置

高速・高精度を実現

アルファイン
デザイン

【長野】アルファインデザイン（長野県東御市、森澤正良社長、0268・64・0088）は、

1・5秒ごとに1チップの実装と位置決め精度2μm（マイクロは100万分の1）を実現したICチップ向け実装装置「フリップチップボンダーHSB-3000」写真」を完成、9月に発売



する。価格は未定。半導体メーカー向けに09年6月までに10台の販売を目指す。

同装置は半導体装置業界で最高水準の高速・高精度ICチップ実装を実現した。本体は幅135mm×奥行き135mm×高さ190mmで、12mmチップ実装にも対応できる。チップと基板の接合は微調整が可能な加熱・加圧方式で、電気的特性が向上できる超音波方式もオプションに加える。

新装置投入とともに6月中に、福岡市内に開発センターを設置する。

「新装置の販売強化、九州大学との共同開発、技術者採用の拠点としたい」（森澤社長）としている。